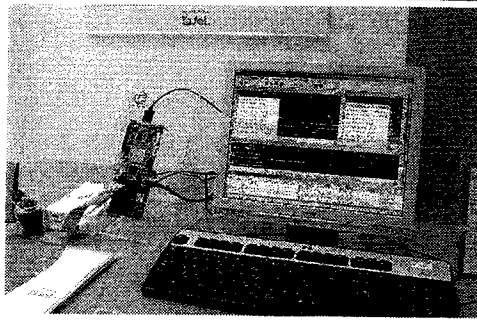


OS/ミドルウェア



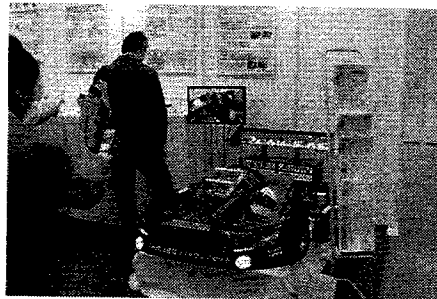
イーソルのマルチコア対応OS「eT-Kernel」のデモ

「eT-Kernel」は、ARM社製マルチコア「MPiCore」を搭載し、OS「eT-Kernel」のデモを

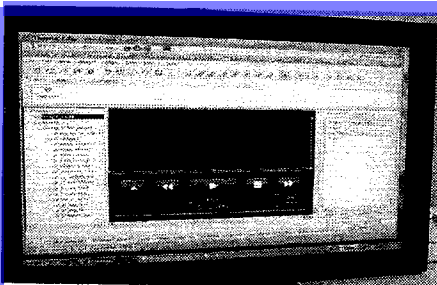
マルチコア対応のOSデモ

直感的にデザイン GUIフレームワークなども提案

世代的リアルタイムOS「WinVista」搭載パソコンを介して間接的にネットワーク接続されたデバイス、直接接続されたデバイスのように扱えるなどの新機能を盛り込んだ。紹介。ASPカーネルは「アドバンスド・データ・コントロールズ」は、OS、



TOPPERSプロジェクトの開発した保護機能OSの実証実験で使用された車両。同実証実験には、アイシン精機、東海理化などが参加した



NexWaveの「NexGUI」のGUIデザインデモ

器、POS、FA分野での採用を見込んでいる。NexWave社は開発初日に、独自のコンポーネント化技術を駆使して開発したGUIフレームワーク「NexGUI」を発売した。ウィジェットと呼ばれる画面を構成するボタンやイメーシなどの部品を配置するだけの操作で、直感的にGUIデザインが行え、開発期間を大幅に短縮できる。

「eT-Kernel」は、ARM社製マルチコア「MPiCore」を搭載し、OS「eT-Kernel」のデモを

世界が注目、最新組み込み技術

07E T

タンダードプロファイルに準拠するTOPPERS/JSPカーネルを改良、拡張した。一般公開は08年5月に計画している。

マイクロソフトもET2007開催に合わせ、組み込み向けOS「Windows Embedded CE 6.0 R2」(以下、CE6.0 R2)の供給開始を発表した。サービス指向型デバイスの実現を目指す

日本テキサス・インスツルメンツは、ポータブル医療機器向けのマイクロコントローラ・ユニット(MCU)「MSP430FG4270」を発売した。価格は511円(税別で1万個受注時の参考単価)。

新製品は、大容量のオンチップメモリとADCコンバータ、DACコンバータといったアナログ周辺に加工し、機器を使用する際には

え、オペアンブまでチップ上に内蔵することで、ポータブル医療機器設計における部品点数や基板面積を最小限まで削減できる。

CPUコアは、16bit RISCアーキテクチャを持ち、1.1GHzと極めて低い消費電力(スタンバイ時)をはじめ、五つの低消費電力モードを備えており、機器を使用する際には

デンセイ・ラムダのマルチ出力基板型スイッチング電源「ZXシリウス」

アプロスと資本・業務提携 アミューズ機器向けグラフィックLSI 開発を支援

3月期中間電子材料事業部門売上上げ 三菱マテリアル 営業利益が69億円

三菱マテリアルは、08年3月期の中間連結決算をまとめたが、その中で電子材料事業部門の業績は、売上高が前年同期比13.2%増の495億円、営業利益が42.1%増の69億円だった。